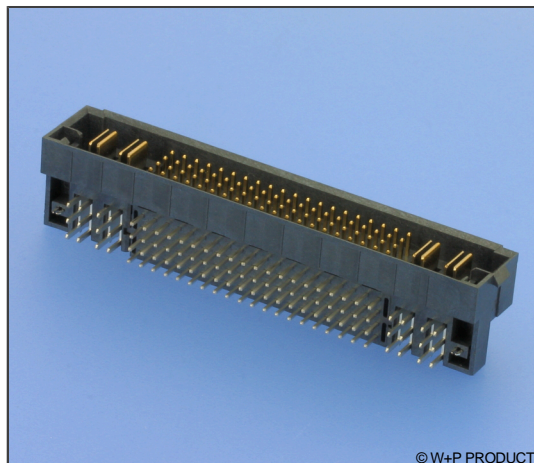


## Power-Signal-Terminal RM 5,00/2,00mm, Stiftkontakte, gewinkelt Power-Terminal 5.00mm Pitch, Male, Right-angled

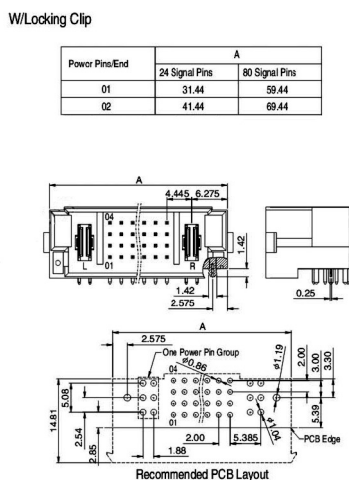
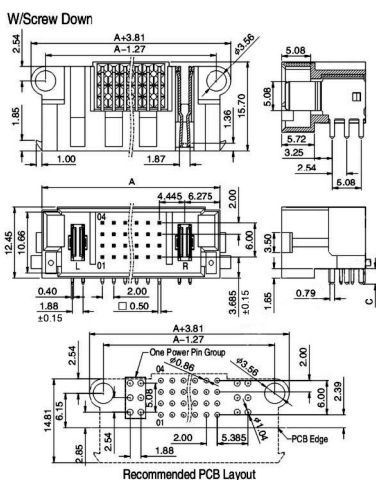
### Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper <i>Insulator</i>	Thermoplast, nach UL94 V-0 <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Kupferlegierung <i>Copper alloy</i>
Kontaktoberfläche <i>Contact Surface</i>	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni <i>Acc. to plating options, over Ni</i>
Nennspannung <i>Voltage Rating</i>	Power: 600 V AC / 848 V DC Signal: 300 V AC / 424 V DC
Nennstrom <i>Current Rating</i>	Power: 600 V AC / 848 V DC Signal: 300 V AC / 424 V DC
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	Power: 24,7 A / Signal: 1 A Power: 24.7 A / Signal: 1 A
Verarbeitung <i>Processing</i>	-55 °C ... +105 °C -55° ... +105 °C 260 °C für 10s 260 °C for 10s



© W+P PRODUCTS

Gegenstecker / Mating Connectors :  
454 (24/80), 456 (24/80)



<b>Series</b>	<b>Power Left*</b>	<b>Signal*</b>	<b>Power Right*</b>	<b>Terminals*</b>	<b>Plating (Power)*</b>	<b>Plating (Signal)*</b>	<b>Board Locks*</b>	<b>Packaging*</b>
<b>457</b>	<b>01</b>	<b>80</b>	<b>01</b>	<b>21</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>20</b>	<b>ST</b>
	01/02 Contacts	24/80 Contacts	01/02 Contacts	20 C=2.72mm 21 C=3.52mm 22 C=4.32mm	00 Au flash 50 Sn 60 Sel. Au/Sn 610 Sel. Au 10µ"/Sn	00 Au flash 50 Sn 60 Sel. Au/Sn 610 Sel. Au 10µ"/Sn	20 Locking Clips 30 Screw down	ST TRAY

\* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -  
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.  
\* This is an **order example** -  
please replace by your specifications.

### Lieferformen / Packaging Options:

ST In Stangen / In tubes  
TRAY Auf Tray / On tray

## Informationen zum Reflow-Lötverfahren Reflow Soldering Information

### Reflow-Lötempfehlung für kurze Lötzeiten

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum $T_{Smin}$	150 °C
Temperatur Maximum $T_{Smax}$	200 °C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Temperatur Lötbereich $T_L$	217 °C
Verweildauer oberhalb $T_L$	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Höchsttemperatur $T_P$	260±5 °C
Dauer Höchsttemperatur	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Dauer 25 °C – Höchsttemperatur $T_P$	max. 8m

### Reflow Soldering Recommendation For Shorter Peak Times

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature $T_{Smin}$	150 °C
Maximum Temperatur $T_{Smax}$	200 °C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Soldering Range Temperature $T_L$	217 °C
Duration above $T_L$	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Peak Temperature $T_P$	260±5 °C
Duration Peak Temperature	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Duration 25°C - Peak Temp. $T_P$	max. 8min

